

2022年12月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

2022年5月13日

上場会社名 ウィンテスト株式会社
 コード番号 6721 URL <https://www.wintest.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 姜 輝
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役 (氏名) 樋口 真康
 四半期報告書提出予定日 2022年5月13日
 配当支払開始予定日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

上場取引所 東
 TEL 045-317-7888

(百万円未満切捨て)

1. 2022年12月期第1四半期の連結業績(2022年1月1日～2022年3月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2022年12月期第1四半期	51	51.2	177		165		165	
2021年12月期第1四半期	105	43.2	207		163		164	

(注) 包括利益 2022年12月期第1四半期 125百万円 (%) 2021年12月期第1四半期 126百万円 (%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2022年12月期第1四半期	4.96	
2021年12月期第1四半期	4.98	

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2022年12月期第1四半期	2,004	1,591	78.8
2021年12月期	1,896	1,590	83.4

(参考) 自己資本 2022年12月期第1四半期 1,579百万円 2021年12月期 1,581百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2021年12月期		0.00		0.00	0.00
2022年12月期					
2022年12月期(予想)		0.00		0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2022年12月期の連結業績予想(2022年1月1日～2022年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計) 通期	2,000	550.2	205		204		204		6.20

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- | | |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 有 |
| 以外の会計方針の変更 | : 無 |
| 会計上の見積りの変更 | : 無 |
| 修正再表示 | : 無 |

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2022年12月期1Q	33,963,000 株	2021年12月期	33,041,000 株
期末自己株式数	2022年12月期1Q	株	2021年12月期	株
期中平均株式数(四半期累計)	2022年12月期1Q	33,381,242 株	2021年12月期1Q	33,041,000 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますことをご了解ください。また、上記予想の前提条件、その他関連する事項については、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(1)経営成績に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(会計方針の変更)	8
(セグメント情報等)	9
(重要な後発事象)	10
3. その他	11
継続企業の前提に関する重要事象等	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間（2022年1月1日～2022年3月31日）における世界経済は、前々年度から続く新型コロナウイルス感染症の拡大が継続し、中国においては、特に変異型オミクロン株による急激な感染再拡大により、一部の地域でゼロコロナ政策に伴う厳しいロックダウンなど活動制限が実施されており、ロシアにおいては、2月下旬よりウクライナ侵攻が行われており、日本を含む米国並びに欧州各国はロシアへの経済・金融制裁の発動などを引き金にエネルギーの高騰と我が国の低金利政策継続を受けた円安が進行するなど、次期の我が国経済に与える影響も不透明感があります。また、我が国においても同様に、新型コロナウイルスの新たな変異株の登場による活動制限が再び強化され、景気への下押し圧力が強まる状況もありましたが、ワクチン接種や徹底した飛沫感染対策等の進展から、行動制限の順次緩和が行われた結果、3月以降景気は回復基調に転じております。

当社グループが属する半導体並びにフラットパネルディスプレイ業界におきましては、新型コロナウイルス感染症再拡大による消費市場へのネガティブインパクト、半導体不足及び不安定なサプライチェーンに伴う、半導体関連部材の供給不安が前年に増して深刻化、家電、車、産業機械方面全般の製造遅延が見られるものの、今後、5G関連のインフラ整備、またそれに伴う新サービスの台頭など高速通信技術が先導役となり情報端末は勿論、テレビなど画面の4K、8K化など高精細化、リモートワークに伴うクラウドサーバーの更なる大型化によるデータセンター向け半導体が急伸するなど、長期的に半導体市場の拡大がさらに進むものと考えております。

このような環境下、当社グループの主要事業である半導体検査装置事業では、情報端末や、スマートフォン向け半導体分野への精力的な設備投資を続けてきた中国及び台湾にビジネスチャンスを求め、現地の顧客ニーズに適合したLCDドライバーIC検査装置を開発するとともに、中国子会社に販売機能を持たせ、現地マーケットに集中した営業展開をしております。しかし、2022年2月に発生したロシアのウクライナ侵攻に端を発する、ロシアに向けた西側諸国による経済制裁に加え米国の利上げから極端な円安も懸念されるところではありますが、2022年2月の北京オリンピック終了の後、急激な新型コロナウイルス禍の拡大を理由に半導体産業関連が集中する中国主要各都市でロックダウンが長期化していることで、営業活動やエンジニアの渡航と作業等に大きな制約があり、当社グループの事業活動は、大きな影響を受けました。また当社に限らず、世界経済全体で見てもあらゆる市場において、原材料・エネルギー・ロジスティックコストの高騰、サプライチェーンの混乱、そして半導体不足による生産制限の継続など広範囲に影響が及びました。

これらの結果、当第1四半期連結累計期間の当社グループの売上高は51,678千円（前年同四半期比51.2%減）、営業損失177,005千円（前年同四半期は営業損失207,072千円）、経常損失165,033千円（前年同四半期は経常損失163,559千円）、親会社株主に帰属する四半期純損失165,652千円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失164,421千円）となりました。

なお、セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

半導体検査装置事業においては、上述のように、営業活動やエンジニアの渡航と作業等に大きな制約があり、当社グループの事業活動は、大きな影響を受けました。この結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は50,728千円（前年同四半期比43.9%減）、営業損失175,746千円（前年同四半期は営業損失198,074千円）となりました。顧客工場におけるベンチマークやデータ相関等無事終了したことを受け、現在受注獲得に向けた交渉を行っております。また、今後とも顧客のニーズに対応した装置と機能拡張オプションの開発・改善を継続し、検査機能の拡充と高速化を図るとともに、新型コロナウイルス禍の影響が色濃い状況ではございますが、販売店等との協力、連携を深め中国市場により強い攻勢をかけ、リピートそして、新規顧客開拓（ベンチマークや装置の評価貸出し）を積極的に行ってまいります。

報告セグメント「新エネルギー関連事業」については、2021年10月21日付にてオランジュ株式会社の全株式を売却したことから、当第1四半期連結累計期間において報告セグメントを廃止しております。

なお、「その他」の事業セグメントに関しましては、当社が行っているオーディオ事業を含んでおりますが、重要性が低いことから、報告セグメントとはしておりません。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度に比べ106,603千円増加し、1,977,385千円（前連結会計年度末比5.7%増）となりました。この主な要因は、現金及び預金が82,762千円増加したことによるものです。

固定資産は、前連結会計年度に比べ1,404千円増加し、26,834千円（前連結会計年度末比5.5%増）となりました。この主な要因は、投資その他の資産のその他が1,404千円増加したことによるものです。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度に比べ11,057千円増加し、212,931千円（前連結会計年度末比5.5%増）となりました。この主な要因は、1年以内返済予定の長期借入金が19,044千円増加したことによるものです。

固定負債は、前連結会計年度に比べ95,625千円増加し、199,535千円（前連結会計年度末比92.0%増）となりました。この主な要因は、長期借入金が増加したことによるものです。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度に比べ1,325千円増加し、1,591,753千円（前連結会計年度末比0.1%増）となりました。この主な要因は、資本金及び資本剰余金が増加したことによるものです。

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社が「主力装置」と位置付けるLCDドライバIC検査装置が活躍するディスプレイや情報端末市場は、新型コロナウイルス感染症によって強制された在宅ライフスタイルにより、一時的な品薄が引き起こされFPDパネルの相対的な価値を高めることになりました。今後近未来におけるディスプレイ市場を考えると、5Gにおけるディスプレイの高精細化によるイノベーションチェンジが大きく期待され、需要は今以上に伸長するものと考えられます。これは同時にそれらの製品に使われるCMOSイメージセンサーIC、ロジックICなど周辺半導体デバイスの需要も同時に大きく伸びることを意味します。この波を確実に当社では高品位、低コスト、高速化を念頭に置いた開発は勿論のこと、更にユーザーフレンドリーなGUI機能強化をそれぞれ推し進め、新たな検査ニーズに対応する検査技術や手法の開発を継続してまいります。また、同市場は中国・台湾の台頭が著しく、当社のメイン市場として捉え、中国に製造子会社「偉恩測試技術（武漢）有限公司」（以降「製造子会社」という。）を設立しております。また同製造子会社に販売店機能を持たせることで、日々変化する半導体市場への迅速な対応ができる体制を整えております。これにより中国、台湾マーケットへの深耕・量産体制の確立等を更に進め営業体制の強化に努めてまいります。これはまた、スピーディーで顧客満足度の高いプリ・ポストサービスの提供ができる体制固めとなるとともに、社内ではコストの削減、また製造品質の向上及び納期の短縮などが見込まれます。

また、台湾の「蔚華科技股份有限公司」（以降「販売店」という。）と販売店契約を取交わしており、当社グループとの間で同販売店とエンジニアによる協業体制による相互協力体制を構築、ベンチマーク及び検査データ相関を実施し中国及び台湾の顧客に向けたビジネス戦略を取っております。

2021年中は、世界的に新型コロナウイルスの蔓延が問題となり営業・技術戦略もリモートとせざるを得ず、当社の事業活動に大きな制約となっており影響があったことを受け、当第1四半期連結累計期間から現地へ出張も可能とし、渡航などの手続きを含め準備に邁進しておりましたが、2022年2月の北京オリンピック終了の後、急激な新型コロナウイルス禍の拡大を理由に半導体産業関連が集中する中国主要各都市でロックダウンが長期化、現地での営業活動はもとより、日本からの渡航による営業やエンジニアによる現地作業と指導などが不可能となり、大きな制約が発生し事業活動に、大きな影響を受けました。また当社に限らず、世界経済全体で見てもあらゆる市場において、原材料・エネルギー・ロジスティックコストの高騰、サプライチェーンの混乱、そして半導体不足による生産制限の継続など広範囲に影響が及びました。

現在当社の主力製品である最新のWTS-577SRIにつきましては、現状、前期からの顧客工場におけるベンチマークや量産に向けてのデータ相関は順調に推移、又は終了しておりますが、今般の半導体不足並びに物流の混乱などに起因する検査装置周辺機器（ウエーハ・プローバ等）の納入が遅れており、当社グループの新規受注・売上は第2四半期以降となります。今後、暫くは中国、台湾各地における渡航時の長期隔離などが続くものと考えられますが、長期に亘る隔離を押し、営業並びにエンジニアの派遣、常駐などを強力に進めるとともに、引続き販売店の指導、中国製造子会社の営業並びに技術品質の指導を行い、現地営業とアフターサポート体制の拡充、強化を進め、積極的に受注・納品の促進及び中国における販売チャンネルを活かし、複数企業からの受注に向けて事業活動を強化してまいります。

自重補償機構技術に関し、学校法人慶応義塾大学慶應義塾先端科学技術研究センターと共同開発を進めており、ますが、2022年3月24日付にて、半導体検査のラインで稼働を予定する「自重補償機構」型搬送装置製品のプロトタイプ完成をお知らせいたしました。当該技術は、当社の検査装置をウエーハ搬送装置とのドッキングに使用する「マニピュレータ」としての製品化を目指しますが、いかなる動力源も必要としないというその特色を活かし半導体工場向けに留まらず、流通分野やアグリ方面への応用を進めてまいります。なお、基本設計並びに特許関連の手続きは終わり、2022年度中には一部当社装置に搭載できるものと考えております。

半導体IoTセンサー分野では、奈良県立大学並びにTAOS研究所と進めております脈波（ECG、BCGを利用したバイタルデータ）を利用したヘルスケア管理システムにつきましては、2022年4月4日に公表しました「セルフヘルスケア製品の完成と販売開始についてのお知らせ」のとおり完成しました。周辺ソフトウェアなどの整備を行い、2022年10月頃から販売を開始いたします。なお、販売はTAOS研究所が自らの既存の販売チャンネルによる販売となる予定です。

なお、2022年2月15日の「2021年12月期 決算短信」で公表いたしました連結業績予想に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	219,109	301,872
受取手形及び売掛金	36,517	—
売掛金	—	25,081
商品及び製品	159,086	217,230
仕掛品	813,968	777,558
原材料及び貯蔵品	510,474	536,498
前渡金	11,421	7,818
未収消費税等	45,418	46,972
その他	74,785	64,352
流動資産合計	1,870,782	1,977,385
固定資産		
有形固定資産		
建物	8,182	8,182
減価償却累計額	△8,182	△8,182
建物(純額)	—	—
車両運搬具	8,885	8,885
減価償却累計額	△8,885	△8,885
車両運搬具(純額)	—	—
工具、器具及び備品	181,952	181,952
減価償却累計額	△181,952	△181,952
工具、器具及び備品(純額)	—	—
有形固定資産合計	—	—
投資その他の資産		
その他	28,313	29,718
貸倒引当金	△2,884	△2,884
投資その他の資産合計	25,429	26,834
固定資産合計	25,429	26,834
資産合計	1,896,211	2,004,219

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	82,766	88,032
未払金	49,821	33,685
1年内返済予定の長期借入金	13,020	32,064
未払法人税等	848	3,791
賞与引当金	—	7,108
製品保証引当金	1,907	2,150
前受金	4,810	—
契約負債	—	24,476
その他	48,699	21,622
流動負債合計	201,873	212,931
固定負債		
長期借入金	96,964	192,661
リース債務	514	471
資産除去債務	6,325	6,348
その他	106	54
固定負債合計	103,910	199,535
負債合計	305,783	412,466
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,000,000	1,065,248
資本剰余金	1,286,486	1,351,734
利益剰余金	△775,689	△947,966
株主資本合計	1,510,797	1,469,016
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	70,434	110,671
その他の包括利益累計額合計	70,434	110,671
新株予約権	9,196	12,065
純資産合計	1,590,428	1,591,753
負債純資産合計	1,896,211	2,004,219

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
売上高	105,829	51,678
売上原価	124,771	42,438
売上総利益又は売上総損失 (△)	△18,941	9,239
販売費及び一般管理費	188,130	186,245
営業損失 (△)	△207,072	△177,005
営業外収益		
受取利息	277	7
為替差益	42,665	12,601
その他	733	303
営業外収益合計	43,676	12,912
営業外費用		
支払利息	163	655
その他	0	285
営業外費用合計	163	940
経常損失 (△)	△163,559	△165,033
税金等調整前四半期純損失 (△)	△163,559	△165,033
法人税、住民税及び事業税	862	619
法人税等調整額	—	—
法人税等合計	862	619
四半期純損失 (△)	△164,421	△165,652
親会社株主に帰属する四半期純損失 (△)	△164,421	△165,652

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
四半期純損失 (△)	△164,421	△165,652
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	38,271	40,237
その他の包括利益合計	38,271	40,237
四半期包括利益	△126,150	△125,415
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△126,150	△125,415
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当第1四半期連結累計期間(自2022年1月1日至2022年3月31日)

当社は、当第1四半期連結累計期間より、第三者割当の方法による第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の権利行使による新株発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ65,248千円増加し、当第1四半期連結会計期間末において資本金が1,065,248千円、資本剰余金が1,351,734千円となっております。

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、契約における約束した財又はサービスの独立販売価格の合計額が当該契約の取引価格を超える場合には、契約における財又はサービスの束について顧客に値引き等を行っているものとして、当該値引き等について、契約におけるすべての履行義務に対して比例的に配分する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高は、6,624千円減少しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は当第1四半期会計期間より「売掛金」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当第1四半期会計期間より「契約負債」に組み替えて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。

なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			その他 (注) 2	調整額 (注) 3	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 1
	半導体検査 装置事業	新エネルギー 関連事業	計			
売上高						
外部顧客への売上高	90,390	13,575	103,965	1,864	—	105,829
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—	—
計	90,390	13,575	103,965	1,864	—	105,829
セグメント損失	△198,074	△8,005	△206,080	△1,265	273	△207,072

(注) 1. セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

2. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、当社が行っているオーディオ事業を含んでおります。

3. セグメント損失の調整額273千円は、セグメント間取引消去によるものであります。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれんに関する情報

該当事項はありません。

II 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント		その他 (注)	四半期連結 損益計算書 計上額
	半導体検査 装置事業	計		
売上高				
外部顧客への売上高	50,728	50,728	949	51,678
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—
計	50,728	50,728	949	51,678
セグメント損失	△175,746	△175,746	△1,258	△177,005

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、当社が行っているオーディオ事業を含んでおります。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれんに関する情報

該当事項はありません。

3. 報告セグメントの変更等に関する事項

報告セグメント「新エネルギー関連事業」については、2021年10月21日付にてオランジュ株式会社の全株式を売却したことから、当第1四半期連結累計期間において報告セグメントを廃止しております。

(重要な後発事象)

新株予約権の行使による増資

当第1四半期連結会計期間の末日の翌日以降、2022年5月12日までに第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の一部の権利行使が行われました。当該新株予約権の行使により発行した株式の概要は以下のとおりであります。

(1) 行使新株予約権個数	3,040個
(2) 資本金の増加額	20,548千円
(3) 資本準備金の増加額	20,548千円
(4) 増加した株式の種類及び株数	普通株式 304,000株

3. その他

継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、前連結会計年度については昨今の半導体不足に端を発する有力顧客であるデザインハウス並びに関係するOSAT（テストハウス）の稼働率低下を受け、売上・受注時期がずれ込み、営業損失730,710千円となり、親会社株主に帰属する当期純損失629,178千円を計上しております。なお、営業キャッシュ・フローは、売上債権の増加等により856,085千円のマイナスとなりました。

また、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの半導体検査装置事業については、中国・台湾において新型コロナウイルス感染症の再拡大となり、2022年2月の北京オリンピック終了の後、急激な感染の拡大を理由に半導体産業関連が集中する中国主要各都市でロックダウンが長期化、前連結会計年度にもまして、営業活動やエンジニアの渡航と作業等に大きな制約が発生し、当社グループの事業活動が大きな影響を受け、受注・売上時期は第2四半期以降となる見込みであり、当第1四半期は低調に推移しました。その結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は50,728千円となりました。

以上より、当社グループの連結ベース売上高は、51,678千円にとどまり、営業損失177,005千円となり、親会社株主に帰属する四半期純損失を165,652千円計上しております。

当該状況により、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループはこうした状況を解消するため、以下の取組みを継続して実施しております。

まず、半導体検査装置事業では、今後、5G関連のインフラ整備、またそれに伴う新サービスの台頭など高速通信技術が先導役となり情報端末は勿論、テレビなど画面の4K、8K化など高精細化、リモート会議が常態化するなどDX化の進展に伴いITのクラウド化の更なる拡大によるデータセンター向け半導体が急伸するなど、長期的に半導体市場の拡大がさらに進むものと考えております。当社グループとして、それらの技術変化に応じたタイムリーな検査技術の開発が必須となります。当該状況の解消策として、当社グループは2020年1月より開発体制を整備し、新技術の開発に多くのリソースをかけてまいりました。その結果、2022年3月14日付で「先端半導体検査用高速ドライバSSDR 4 Gbps」の開発完了とリリースを行い、また2022年3月24日には、半導体検査のラインで稼働を予定する「自重補償機構」型搬送装置製品のプロトタイプを完成しました。また、2022年3月25日に当社の得意とするイメージセンサーの検査装置分野向けとして「イメージセンサー検査用最新型光源ソース」の開発完了とリリースを行い、2022年3月28日には、「先端イメージセンサー検査向け新技術MIPI-D-PHY高速キャプチャー」機能の開発完了と出荷を実現しました。現在も新機能、新装置の開発を継続しております。それらの新技術製品は、当社新型装置WTS-577SRに搭載出荷が開始されており、また現在開発中の次世代先端検査装置にも搭載される予定です。現状、前期からの顧客工場におけるベンチマークや量産に向けてのデータ相関は順調に推移、又は終了しておりますが、今般の半導体不足並びに物流の混乱などに起因する検査装置周辺機器（ウエーハプロバ等）の納入が遅れており、当社グループの新規受注・売上は第2四半期以降となります。今後、暫くは中国、台湾各地における渡航時の長期隔離などが続くものと考えられますが、自粛しておりました営業並びにエンジニアの派遣、常駐などを強力に押し進めるとともに、引続き販売店の指導、中国製造子会社の営業並びに技術品質の指導を行い、現地営業とアフターサポート体制の拡充、強化を進め、積極的に受注・納品の促進及び中国における販売チャンネルを活かし、複数企業からの受注に向けて事業活動を強化してまいります。なお、2021年度中に出荷を見合わせておりました受注済の検査装置に関し、2022年1月から順次出荷を開始しており、売上計上を行う予定であります。

つぎに、当社100%出資の中国製造子会社において、現在、既存装置に係る製造と販売は、主に中国製造子会社に移しており、大阪事業所は一部既存装置の製造能力は残すものの、新型次世代装置の開発設計と製造に注力してまいります。

そして、台湾、中国顧客向けに開発中の汎用ロジックテスターWTS-677-512及びWTS-577Logic-1024については、半導体ICの駆動能力を100MHzから250MHzへと大きく進化させ、先端ロジック検査に対応させると同時に広範囲のロジックIC検査に対応するためのアナログオプションの追加機能の開発を完了し、日本を含むアジア方面のお客様に営業攻勢をかけてまいります。（WTS-577Logic-1024は、現行LCDドライバー最新検査装置WTS-577SRをロジック検査に最適化させた装置となり。コンパクトなWTS-677に対し、2倍となる1024PINを搭載可能です。）

新たな収益の柱を構築するための成長戦略として、2025年までに当社グループがこれまで培ってきた検査技術や画像処理技術、高精度センサー技術、データ解析技術を応用、且つ大阪事業所の技術陣と協働し、今後の市場拡大が見込まれるメモリーデバイス検査分野、5G通信規格の台頭とともに注目を集めるパワーデバイス検査分野への進出を目指し、M&Aなども視野にシナジーの高い事業会社との資本・業務提携、並びに産学連携を積極的に進め、当該分野への新規参入、対応可能検査範囲の拡充と展開を計画、収益基盤の拡充に取り組んでまいります。

自重補償機構技術に関し、学校法人慶応義塾大学慶應義塾先端科学技術研究センターと共同開発を進めており、上述のように、2022年3月24日付にて、半導体検査のラインで稼働を予定する「自重補償機構」型搬送装置製品のプロトタイプの完成をお知らせいたしました。当該技術は、当社の検査装置をウエーハ搬送装置とのドッキングに使用する「マニピュレータ」としての製品化を目指しますが、いかなる動力源も必要としないというその特色を活かし半導

体工場向けに留まらず、流通分野やアグリ方面への応用を進めてまいります。なお、基本設計並びに特許関連の手続きは終わり、2022年度中には一部当社装置に搭載できるものと考えております。

当社が奈良県立大学並びにTAOS研究所と進めております脈波 (ECG, BCG) を利用したバイタルデータ) を利用したヘルスケア管理システムにつきましては、2022年4月4日に公表しました「セルフヘルスケア製品の完成と販売開始についてのお知らせ」のとおり完成しました。周辺ソフトウェアなどの整備を行い、2022年10月頃から販売を開始いたします。なお、販売はTAOS研究所が自らの既存の販売チャンネルを使って販売する予定です。

経費水準については、大阪事業所並びに中国製造子会社の開設に伴う運転資金及び研究開発費等により増加しておりますが、国内における製品の製造委託コストに変化はないものの、部材調達につきましては、半導体不足の影響を色濃く受けており、その納期の長期化やコストの上昇が深刻ではありますが、経営判断により2021年前半に思い切った部材調達を行いました。しかし、その甲斐あって、今年度は半導体不足に影響されることなく、装置の納期、サポートともにスピーディに行うことができます。上述のとおり、日本からの積極的な応援体制を推し進め現地での製品やサポートの品質向上にも同時に取り組み、売上予算の達成に向けて邁進いたします。

財務面については、折からの半導体不足が深刻さを増し、当社の検査装置に不可欠な半導体部品の大幅な納期遅延、大幅な価格高騰を受け、タイムリーな装置製造に支障がでる恐れがあるとの判断から、2021年前半に必要な部材仕入れを行った結果、運転資金となる現預金が減少しております。

そこで財務基盤の安定化を図るために、2021年11月に金融機関からの新規借入を行い、更に2022年1月31日に開催の取締役会において、割当予定先への第三者割当による新株予約権の発行を決議し、2022年2月21日にその払込も完了いたしました。これにより、今後の事業継続に必要な開発及び運転資金を確保するとともに、2022年後半から2023年の製造に必須となる製造部材の調達に必要な資金の確保及び財務基盤の強化を図りました。また、2022年2月28日には今後の運転資金需要に対応するため金融機関からの追加借入を行っておりますが、前記の新株予約権行使による資金調達を引続き行うとともに、筆頭株主である武漢精測と諮りながら、親会社及び金融機関からの借入等による運転資金確保のための施策を実施してまいります。

以上のとおり、台湾、中国を中心とするビジネス機会や売上・受注の増加が見込まれること、受注済みの検査装置の売上・入金が見込まれていること及び上述の資金調達の実施により、今後の運転資金に必要な十分な現預金を確保していることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。